

## 「京都を舞台に！電子デバイスの最新トレンドと未来を描く！」 ～ 西日本最大級の電子デバイスフォーラムで、一般電子部品や半導体をはじめ、すべてをカバー ～

### ■ NEDIA 主催「電子デバイスフォーラム京都」の概要

一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA：2013年9月30日発足)は、一般電子部品、半導体を始めとする電子デバイス産業全体及び川上の材料・製造装置産業から川下のアプリケーション産業まで含めた幅広い分野で横断的戦略組織として、日本の産業発展に寄与すべく活動しています。

「NEDIA 電子デバイスフォーラム京都」は、NEDIAの目指す活動の一環として、開催します。

本フォーラムは、一般電子部品、半導体を始めとした電子デバイス全体の将来の方向を、電子デバイスにおける西日本最大級のフォーラムとして京都から発信して行きます。

次世代自動車・車載部品、ソーシャルデバイス、次世代モバイル・ウェアラブルにフォーカスした将来情報を提供して行きます。

大学セッション、半導体技術の基礎としてのプロセス等のセッションも設けました。

電子デバイス業界は勿論として、電子デバイスを支える装置・材料業界、電子デバイスを採用いただくアプリケーション業界の方々に参加いただくことを目指しており、各位のご参加をお願い致します。

### 【開催日時・場所】

■ 日時：2014年10月30日(木) 10:00～ 10月31日(金) 17:00

■ 場所：京都リサーチパーク(KRP)

〒600-8813

京都市下京区中堂寺南町134番地東地区1号館/KISTIC

URL：<http://www.krp.co.jp>

1号館4階：サイエンスホール、AV会議室、中会議室、  
ホワイエ

KISTIC2階：イノベーションルーム

(1号館とつながっています)



京都リサーチパーク(KRP) 東地区1号館 入口

### 【プログラム】

■ 挨拶・基調講演(10月30日午前)：講演3件

■ 特別マーケット情報セミナー(10月30日午前)：講演2件

### ■ 次世代自動車 コース

10月30日午後：ICTとエレクトロニクスが変える次世代・近未来自動車

10月31日午前：次世代自動車のための電子部品実装技術

10月31日午後：自動車の未来を支える次世代パワー半導体

## ■ソーシャルデバイス コース

- 10月30日午後：ソーシャルデバイスがもたらす価値提供と産業変革
- 10月31日午前：センシングデバイスの最新動向と応用展開
- 10月31日午後：高速ネットワークが作り出す生体医療・スポーツへの応用・展開

## ■次世代モバイル・ウェアラブル コース

- 10月30日午後：スマホからウェアラブルデバイスへ広がるアプリケーション
- 10月31日午前：モバイル・ウェアラブル機器電源の最新動向 ～ エネルギーハーベスティング ～
- 10月31日午後：次世代モバイル・ウェアラブル機器向け電子部品の最新動向

## ■特別セッション

- 10月30日午後：大学セッション ナノテクノロジープラットフォームと産学連携（**無料で参加できます**）
- 10月31日午前：初心者のための半導体基礎講座①
- 10月31日午後：初心者のための半導体基礎講座②

## 【レセプション】

- 10月30日 17:00-18:30：レセプション 参加費：3,000円

セッションにご参加いただいた方は無料でご参加いただけます(大学セッションを除く)

レセプションのみにご参加希望の方は事務局に連絡下さい

## 【展示会】

- 10月30日 10:00～17:00、10月31日 10:00～17:00：4階ホワイエ  
15～20件の小規模なポスター等の展示会を予定（**展示会は、無料でご覧いただけます**）

【参加費】	(一般)	(NEDIA 会員 大学教職員)	(学生)
(単位：円)			
1セッション	: 15,000	12,000	2,000
1Day パス(2セッション)	: 25,000	18,000	3,000
2Day パス(4セッション)	: 45,000	30,000	5,000

宿泊ご希望の方は、手配が可能ですので事務局に相談願います

## 【開催者】

- 主催：一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)
- 特別協力：リード エグジジション ジャパン株式会社、半導体産業新聞（株式会社 産業タイムズ社）
- 後援：経済産業省近畿経済産業局、京都府、京都市
- 協賛：IEEE 関西支部
- 協力：ナノテクノロジープラットフォーム

## 【連絡先】

- 一般社団法人日本電子デバイス産業協会 事務局

TEL：03-5823-4465 FAX：03-5823-4475

E-mail：[ddf.info@nedia.or.jp](mailto:ddf.info@nedia.or.jp) …「電子デバイスフォーラム京都」専用のメールアドレスです。

参加のお申し込みは、<http://nedia.bizserv.jp> からお願い致します。

## 電子デバイスフォーラム京都 委員会構成

### [組織委員会]

	氏名	所属
委員長	齋藤 昇三	NEDIA代表理事・会長、株式会社東芝 常任顧問
副委員長	堀場 厚	株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長
	村田 恒夫	株式会社村田製作所 代表取締役社長
	澤村 諭	ローム株式会社 代表取締役社長

### [実行委員会]

	氏名	所属
委員長	泉谷 渉	NEDIA理事・副会長、(株)産業タイムズ社代表取締役社長
副委員長	南部 修太郎	NEDIA理事・NEDIA関西代表、(株)アセット・ウィッツ代表取締役
	田中 岳志	リードエグジビション ジャパン(株)取締役 第一事業本部長
委員	中村 孝	ローム(株)パワーエレクトロニクス研究開発部 部長
	戸所 義博	奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科NAISTナノテクノロジープラットフォーム連携マネージャー
	中村 行宏	京都大学名誉教授、(公財)京都高度技術研究所 名誉顧問
	松下 晋司	(株)産業タイムズ社編集部 記者 兼事業開発部
	(中村 剛)	(株)産業タイムズ社大阪支局編集部 記者
	周藤 仁吉	NEDIA常務理事・事務局長

### [プログラム委員会]

	氏名	所属
委員長	中村 孝	ローム株式会社 研究開発本部 統括部長
副委員長	戸所 義博	奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科NAIST ナノテクノロジープラットフォーム 連携マネージャー
委員	山崎 治	シャープ株式会社 電子デバイス事業本部 事業戦略推進室 新規事業Gr
	岡田 健治	パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社 プロセステクノロジーセンター基盤技術グループ信頼性開発チームリーダー
	松浦 正純	ルネサス エレクトロニクス株式会社 生産本部 プロセス技術統括部
	岡田 吉生	日本IBM株式会社 マイクロエレクトロニクス事業 クライアント技術部 部長
	山本 浩之	マイクロンジャパン株式会社 R&Dビジネスプロセスインテグレーションマネージャー
	廣田 良浩	東京エレクトロン株式会社 先端プロセス開発センターFEOLプロセス開発グループ グループリーダー
	酒井 滋樹	日新イオン機器株式会社 I/I事業センター テクニカルマーケティングクラスター クラスターリーダー
	遠藤 政孝	大阪大学 産業科学研究所 特任教授
	雲梯 隆夫	UNATE
	木村 匡雄	ソニー株式会社 デバイスソリューション事業本部 イメージセンサ事業部 ISビジネス1部 統括部長
	藤原 健典	東レ株式会社 電子情報材料研究所 主任研究員
	佐藤 高史	京都大学大学院 情報学研究科 通信情報システム専攻 教授
	柴田 随道	NTTマイクロシステムインテグレーション研究所 所長
	中谷 和義	株式会社 村田製作所 技術・事業開発本部 技術企画統括部 技術企画部 部長
	田中 岳志	リードエグジビション ジャパン(株)取締役 第一事業本部長
アドバイザー	上本 康裕	パナソニック株式会社 AIS社 パワーエレクトロニクス開発センター チームリーダー
	不破 保博	ローム株式会社 LSI生産本部 アドバイザー

### [IR広報委員会]

	氏名	所属
委員長	松下 晋司	(株)産業タイムズ社編集部 記者 兼事業開発部
副委員長	南部 修太郎	(株)アセット・ウィッツ 代表取締役
	和田 悟	セミリンクス 代表

### [展示委員会]

	氏名	所属
委員長	古賀 雅子	リードエグジビション ジャパン(株)第一事業本部セミナー担当次長
会場側担当者	(白樫 早苗)	京都リサーチパーク(株)コンベンション部リーダー

# ■電子デバイスフォーラム京都プログラム

(敬称略)

	10月30日(木)10:30-13:00	コース	10月30日(木)14:00-16:30	10月31日(金)10:30-13:00	10月31日(金)14:00-16:30
A	<b>K-1 挨拶・基調講演</b> ◆来賓挨拶 京都市長 門川 大作 ◆基調講演 「デバイス&システムプラットフォーム整備による国際競争力強化」 ㈱東芝セミコンダクター&ストレージ社 技監 柴田 英毅 ◆基調講演 「寸法微細化だけで進歩を遂げたシリコン超LSI技術の新しい進歩の方向」 東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチフェロー 大見 忠弘 ◆基調講演 「電子デバイスの爆発的成長の新時代が見えてきた!! ~M2M、医療、航空、自動車、鉄道で開花する成長アプリを最新レポート~」 半導体産業新聞特別編集委員 泉谷 渉	<b>次世代自動車</b>	<b>A-1 ICTとエレクトロニクスが変える次世代・近未来自動車</b> 山崎(シャープ)/中村(ローム) ◆自動運転の実用化に向けた取り組みと将来の展望 日産自動車(株) 総合研究所 研究企画部 主任研究員 平林 知己 ◆センサーネットワークとしてのコネクテッドカーが起こすクルマ社会のイノベーション インテル(株) 戦略企画室オートモティブユニット 兼 名古屋大学 客員准教授 野辺 継男 ◆サステイナブルモビリティへの対応と次世代パワー半導体への期待 トヨタ自動車(株) 第3電子開発部 主査 川井 文彰	<b>A-2 次世代自動車のための電子部品実装技術</b> 松浦(ルネサス)/中村(ローム) ◆車載用パワー半導体パッケージング技術の最新動向 ルネサス エレクトロニクス(株) 生産本部 実装技術開発統括部 パワーパッケージ開発部車載パワーパッケージ開発課 課長 小池 信也 ◆車載用パワー半導体モジュールの高放熱・高信頼性実装技術 富士電機(株) 技術開発本部 電子デバイス研究所 次世代モジュール開発センター パッケージ開発部 実装・設備Gr. マネージャー 西村 芳孝 ◆電気-熱-構造連成解析を用いたパワーモジュールの信頼性評価 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 干 強	<b>A-3 自動車の未来を支える次世代パワー半導体</b> 岡田(パナソニック)/山本(マイクロン)、上本(パナソニック) ◆車載用パワーデバイスの現状と今後の進化 ㈱デンソー デバイス事業部 半導体プロセス開発部 部長 深津 重光 ◆SiCパワーデバイス・モジュールの開発・実用化の現状 ローム(株) 研究開発本部 統括部長 中村 孝 ◆高温・高速動作を実現する次世代GaNデバイス関連技術 パナソニック(株) R&D本部 デバイスソリューションセンター パワーエレクトロニクスグループ 主幹技師 永井 秀一
	B		<b>ソーシャルデバイス</b>	<b>B-1 ソーシャルデバイスがもたらす価値提供と産業変革</b> 岡田(日本IBM)/木村(ソニー) ◆M2Mとデータ駆動型経済 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 森川 博之 ◆IoT時代のスマート農業 ~科学とテクノロジーで実現する農業ルネッサンス~ ベジタリア(株)/㈱イラポ・エクスベリエンズ 代表取締役社長 小池 聡 ◆Trillion Sensors Universe時代の新たなヘルスケア ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチ 桜田 一洋	<b>B-2 センシングデバイスの最新動向と応用展開</b> 中谷(村田製作所)/木村(ソニー) ◆高速画像処理とその応用展開~CMOSイメージャの進歩が拓く新機能・新システム~ 東京大学 情報理工学系研究科 教授 石川 正俊 ◆積層一体型熱電素子の開発とセンサネットワーク電源への応用 ㈱村田製作所 先端技術研究開発センター 主任研究員 中村 孝則 ◆医療現場で活躍する光製品、光技術~光の可能性について~ 浜松ホトニクス(株) 営業本部 国内統括部 大阪営業所 所長 小栗 康則
C		<b>次世代モバイル・ウェアラブル</b>		<b>C-1 スマホからウェアラブルデバイスへ広がるアプリケーション</b> 柴田(NTT)/佐藤(京都大学) ◆スマートフォンの進化のあゆみと今後の展開 シャープ(株) 通信システム事業本部 要素技術開発センター 所長 安本 隆 ◆着るだけでヘルスケアに役立つ:衣料X ICTによる生体情報センシングの取り組み 日本電信電話(株) マイクロシステムインテグレーション研究所 部長 佐藤 康博 ◆ウェアラブルデバイスの取り組みについて セイコーエプソン(株) HMD事業推進部 基幹社員 馬場 宏行	<b>C-2 モバイル・ウェアラブル機器電源の最新動向~エネルギーハーベスティング~</b> 戸所(奈良先端大)/藤原(東レ) ◆次世代モバイル・ウェアラブル向けエネルギーハーベスティング ㈱NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー 竹内 敬治 ◆海外におけるエネルギーハーベスティングデバイスとその応用 東京エレクトロデバイス(株) グローバルビジネスデベロップメント部 新谷 浩造 ◆薄型軽量エレクトレット振動発電デバイスと応用例 オムロン(株) マイクロデバイス事業推進本部 技術開発部 技術専門職 積 知範
	D		<b>特別セッション</b>	<b>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォームと産学連携</b> 戸所(奈良先端大) 第1部 講演 ◆微細加工プラットフォームの機能と役割 京都大学 理事・副学長 小寺 秀俊 ◆大阪大学の産学連携とナノテクノロジープラットフォーム 大阪大学 産業科学研究所 副所長・産学連携ナノテクノロジーセンター長 教授 吉田 陽一 第2部 ポスター展示と相談の受付 京都大学・大阪大学・奈良先端科学技術大学院大学のナノテクノロジープラットフォームおよび産学連携部門	<b>D-2 初心者のための半導体基礎講座①</b> 廣田(東京エレクトロ)/酒井(日新イオン機器/藤原(東レ)) ◆半導体のできるまで~半導体デバイス・プロセスの基礎~ ウェストブレイン 代表 西久保 靖彦